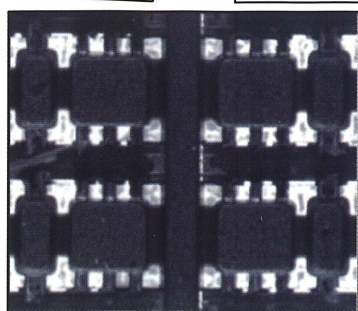
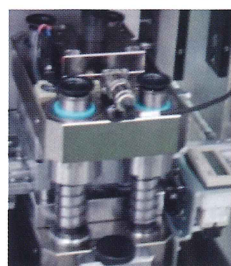
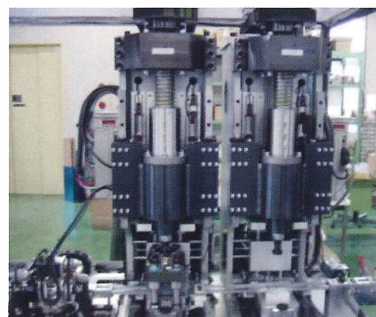
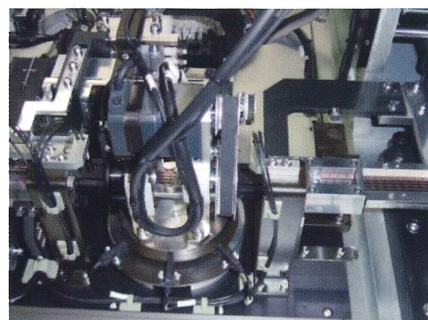
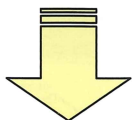
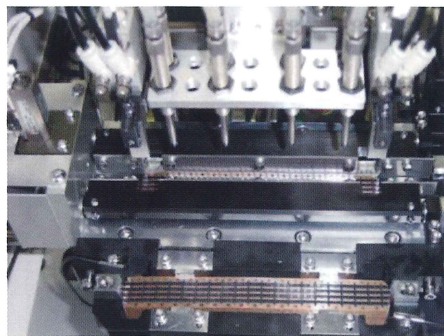


・営業品目 概要

企画段階よりお客様のニーズに応じた装置を設計・製作致します。



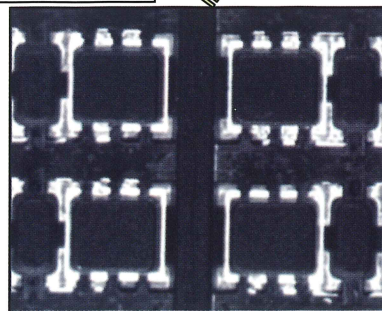
バリ取り前



モールドレーザバリ取り装置

機能説明

- ・ローダ（製品供給）
フレーム収納ラックに収納されている
短冊フレームをハンドにてピックアップ
しシュートに搬送します。
- ・表裏判別
表裏方向判別を行い、一定の向きに
置き換えます。
- ・ゲートカット
サーボプレス機構を採用し、製品に
ダメージを与えずゲートを切断します。
- ・レーザバリ取り
レーザを使い、半導体の外周に存在する
余分なモールドを除去します。
- ・アンローダ（製品収納）
フレームをフレーム収納ラックに
収納します。



バリ取り後

